

第53回ソルダリング分科会プログラム

日時:平成24年 7月 24日(火) 10:00~15:00

場所:科学技術館 6階第1会議室 (東京都千代田区)

主 題 「多様化するソルダリング材料・装置とその品質評価」

時間	題 目	講 演 者
平成 24年 7月 24日  火 曜 日	司会 藤原 伸一 ((株)日立製作所)	
	『実装プロセスにおけるBGA接合不良の原因と対策』 (40分)	千住金属工業(株) ○林田達, 島村将人, 高木和順, 上島稔
	『高温 Pb フリーはんだの評価状況』 (40分)	住友金属鉱山(株) ○井関隆士, 高森雅人
	『ソルダペーストぬれ性評価装置の 開発と方法の提案』 (40分)	山陽精工(株) ○平本清, 西室将 群馬大学 小山真司, 荘司郁夫
12:00~ 12:50	昼 食 休 憩	
12:50~ 13:00	分 科 会 議 事	
13:00~ 15:00	司会 柴崎 正訓 (株)タムラ製作所)	
	『信頼性設計におけるHALT活用技術』 (50分)	楠本化成(株) ○小林吉一, 井原惇行
	『フラックスレスリフロー・実装装置の現状』 (40分)	アユミ工業(株) ○阿部英之
	『はんだリサイクル技術と研究開発動向』 (30分)	東北大学 大学院 環境科学研究科 ○高橋英志, 田路和幸

( )内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。